

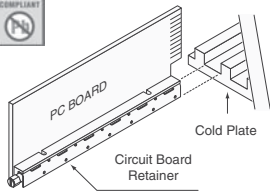
C

图	说明	尺寸 - 英寸 (mm) LxWxH	热阻 °C/W	Digi-Key 零件编号	1	10	100	CTS 零件编号	
18	各种半导体, 背面粘接	1.31 x 1.31 x .355 (33.27 x 33.27 x 9.02)	16.10	294-1100-ND◆	3.30	2.97	2.31	BDN13-3CB/A01	
	各种半导体, 背面粘接	1.41 x 1.41 x .355 (35.81 x 35.81 x 9.02)	16.20	294-1101-ND◆	5.11	4.60	3.58	BDN14-3CB/A01	
	各种半导体, 背面粘接	1.51 x 1.51 x .355 (38.35 x 38.35 x 9.02)	15.10	294-1102-ND◆	3.98	3.58	2.79	BDN15-3CB/A01	
	各种半导体, 背面粘接	1.61 x 1.61 x .355 (40.89 x 40.89 x 9.02)	13.50	294-1103-ND◆	4.08	3.67	2.86	BDN16-3CB/A01	
	各种半导体, 背面粘接	1.71 x 1.71 x .355 (43.43 x 43.43 x 9.02)	11.50	294-1111-ND◆	4.18	3.77	2.93	BDN17-3CB/A01	
	各种半导体, 背面粘接	1.81 x 1.81 x .355 (45.97 x 45.97 x 9.02)	10.80	294-1104-ND◆	4.43	3.99	3.10	BDN18-3CB/A01	
19	各种 SMT 半导体	1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6)	5.3	294-1125-ND◆	4.60	4.14	3.22	APR27-27-12CB	
	各种 SMT 半导体, 带散热胶带	1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6)	5.3	294-1126-ND◆	6.16	5.55	4.32	APR27-27-12CB/A01	
	各种 SMT 半导体, 带短夹	1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6)	5.3	294-1127-ND◆	6.25	5.63	4.38	APR27-27-12CB/S	
	各种 SMT 半导体, 带中号夹	1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6)	5.3	294-1128-ND◆	6.25	5.63	4.38	APR27-27-12CB/M	
	各种 SMT 半导体, 带长夹	1.026 x 1.026 x .457 (26.6 x 26.6 x 11.6)	5.3	294-1129-ND◆	6.25	5.63	4.38	APR27-27-12CB/T	
	各种 SMT 半导体	1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 x 11.6)	3.8	294-1130-ND◆	5.15	4.64	3.61	APR33-33-12CB	
	各种 SMT 半导体, 带散热胶带	1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 x 11.6)	3.8	294-1131-ND◆	6.77	6.10	4.74	APR33-33-12CB/A01	
	各种 SMT 半导体, 带短夹	1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 x 11.6)	3.8	294-1132-ND◆	6.83	6.15	4.78	APR33-33-12CB/S	
	各种 SMT 半导体, 带中号夹	1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 x 11.6)	3.8	294-1133-ND◆	6.83	6.15	4.78	APR33-33-12CB/M	
	各种 SMT 半导体, 带长夹	1.284 x 1.284 x .457 (32.6 x 32.6 x 11.6)	3.8	294-1134-ND◆	6.83	6.15	4.78	APR33-33-12CB/T	
	各种 SMT 半导体	1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6)	3.3	294-1135-ND◆	5.30	4.77	3.71	APR38-38-12CB	
	各种 SMT 半导体, 带散热胶带	1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6)	3.3	294-1136-ND◆	6.35	5.72	4.45	APR38-38-12CB/A01	
	各种 SMT 半导体, 带短夹	1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6)	3.3	294-1137-ND◆	6.95	6.26	4.87	APR38-38-12CB/S	
	各种 SMT 半导体, 带中号夹	1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6)	3.3	294-1138-ND◆	6.95	6.26	4.87	APR38-38-12CB/M	
	各种 SMT 半导体, 带长夹	1.461 x 1.461 x .457 (37.1 x 37.1 x 11.6)	3.3	294-1139-ND◆	6.95	6.26	4.87	APR38-38-12CB/T	
	20	铸制的小尺寸散热片	.748 x .748 x .248 (19 x 19 x 6.3)	7.05	294-1145-ND◆	5.81	5.24	4.07	APF19-19-06CB
		带胶带的铸制散热片	.748 x .748 x .248 (19 x 19 x 6.3)	7.05	294-1146-ND◆	6.16	5.55	4.32	APF19-19-06CB/A01
		铸制的小尺寸散热片	.748 x .748 x .374 (19 x 19 x 9.5)	5.25	294-1147-ND◆	4.79	4.32	3.36	APF19-19-10CB
		带胶带的铸制散热片	.748 x .748 x .374 (19 x 19 x 9.5)	5.25	294-1148-ND◆	6.32	5.69	4.43	APF19-19-10CB/A01
		铸制的小尺寸散热片	.748 x .748 x .500 (19 x 19 x 12.7)	3.95	294-1149-ND◆	5.94	5.35	4.16	APF19-19-13CB
		带胶带的铸制散热片	.748 x .748 x .500 (19 x 19 x 12.7)	3.95	294-1150-ND◆	6.32	5.69	4.43	APF19-19-13CB/A01
		铸制的小尺寸散热片	1.181 x 1.181 x .248 (30 x 30 x 6.3)	4.35	294-1151-ND◆	5.93	5.34	4.15	APF30-30-06CB
		带胶带的铸制散热片	1.181 x 1.181 x .248 (30 x 30 x 6.3)	4.35	294-1152-ND◆	7.51	6.77	5.26	APF30-30-06CB/A01
		铸制的小尺寸散热片	1.181 x 1.181 x .374 (30 x 30 x 9.5)	3.25	294-1153-ND◆	6.13	5.52	4.30	APF30-30-10CB
带胶带的铸制散热片		1.181 x 1.181 x .374 (30 x 30 x 9.5)	3.25	294-1154-ND◆	7.34	6.61	5.14	APF30-30-10CB/A01	
铸制的小尺寸散热片		1.181 x 1.181 x .500 (30 x 30 x 12.7)	2.45	294-1155-ND◆	7.29	6.57	5.11	APF30-30-13CB	
带胶带的铸制散热片		1.181 x 1.181 x .500 (30 x 30 x 12.7)	2.45	294-1156-ND◆	7.75	6.98	5.43	APF30-30-13CB/A01	
铸制的小尺寸散热片		1.575 x 1.575 x .248 (40 x 40 x 6.3)	3.30	294-1157-ND◆	7.06	6.36	4.95	APF40-40-06CB	
带胶带的铸制散热片		1.575 x 1.575 x .248 (40 x 40 x 6.3)	3.30	294-1158-ND◆	8.10	7.29	5.67	APF40-40-06CB/A01	
铸制的小尺寸散热片		1.575 x 1.575 x .374 (40 x 40 x 9.5)	2.50	294-1159-ND◆	7.29	6.57	5.11	APF40-40-10CB	
带胶带的铸制散热片		1.575 x 1.575 x .374 (40 x 40 x 9.5)	2.50	294-1160-ND◆	8.33	7.50	5.84	APF40-40-10CB/A01	
铸制的小尺寸散热片		1.575 x 1.575 x .500 (40 x 40 x 12.7)	1.90	294-1161-ND◆	7.53	6.78	5.27	APF40-40-13CB	
带胶带的铸制散热片		1.575 x 1.575 x .500 (40 x 40 x 12.7)	1.90	294-1162-ND◆	9.17	8.26	6.42	APF40-40-13CB/A01	

◆ 符合 RoHS 规范要求

ZIF III 电路板固定器

ZIF 固定器是一种内含式精密型装置, 在电路板与冷却板之间提供高效热接口。CTS ZIF III 是一种为正向快速组装提供的快速 1/4 循环锁定机制。独特的锁定设计沿着 PCB 边缘统一分配压力, 以在极端撞击和振动的情况下获得最佳热量传输和热阻。



特点:

- PC 板安装 (螺丝安装)
- 正 1/4 旋转锁
- 可现场维护
- 优异的机械保持力
- 散热效率高, 1.2°C-英寸/W

说明	Digi-Key 零件编号	1	10	100	CTS 零件编号
PCB 固定器 - 六角头驱动, 4.50" 体座组件, 左手零件	294-1163-ND	66.24	55.20	48.76	Z3A45SBSBNL
PCB 固定器 - 六角头驱动, 4.50" 体座组件, 右手零件	294-1164-ND	66.24	55.20	48.76	Z3A45SBSBNR
PCB 固定器 - 六角头驱动, 5.25" 体座组件, 左手零件	294-1165-ND	69.35	57.80	51.06	Z3A52SBSBNL
PCB 固定器 - 六角头驱动, 5.25" 体座组件, 右手零件	294-1166-ND	69.35	57.80	51.06	Z3A52SBSBNR

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)